



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% \geq 40 \%$$

- Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża
- P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej.

Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40 % efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.



KARCAD
Chmielowice ul. Spacerowa 23
26-026 Morawica

Nr rys.
33

Temat i adres obiektu:	Projekt remontu budynku remizo-swietlicy w miejscowości Czarnia, Gmina Czarnia.		Skala: 1:10
Inwestor:	GMINA CZARNIA, Czarnia 41 07-431 Czarnia		Data: 10 styczeń 2010r.
Branża:	Budowlana		Podpis
Treść rysunku:	Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.		
Projektował:	mgr inż arch.Grażyna Zak Góra	Specjalność Architektoniczna	Nr uprawnień KL-205/90
Sprawdził:	mgr inż arch.Marek Góra	Architektoniczna	202/84
Opracował:	mgr inż Urszula Warzecha Tywoniuk		